



PIC16F722A-I/SS

Număr parc	PIC16F722A-I/SS	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	48642 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 28SSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Next Generation Peripherals Brochure.pdf PIC16F,LF722A,723A.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

48642 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	25 pcs	100 pcs
\$0.83	\$0.759	\$0.70

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de PIC16F722A-I/SS

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.8V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	28-SSOP
Viteză	20MHz	Serie	PIC® XLP™ 16F
Dimensiunea RAM	128 x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	3.5KB (2K x 14)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)	Pachet	Tube
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	25	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 11x8b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	PIC
Conectivitate	I ² C, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	PIC16F722

Vești înrudite



Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserSony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/07/4

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureEmbedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

2023/09/6

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

2023/03/15

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21